

## 台灣發明協會 函

地址：241608新北市三重區重陽路一段1號  
4樓之11

承辦人：秘書處 吳秋瑾

電話：02-66057626

電子信箱：tia7626@yahoo.com.tw

受文者：屏東縣立明正國民中學

發文日期：中華民國115年3月24日

發文字號：台發協字第1150003039號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：2026美國矽谷國際發明展簡章 1. 邀請函2. 報名表3. 切結書  
(0003039A00\_ATTCH12. pdf、0003039A00\_ATTCH13. doc、0003039A00\_ATTCH14.  
doc)

主旨：敬邀 貴校參加「2026美國矽谷國際發明展」，請協助轉  
知師生踴躍報名參加。

說明：

- 一、2026美國矽谷國際發明展（SVIIF 2026）即將在8月開展，敬邀貴校師生參與，請惠予公告並鼓勵師生踴躍參加，以提倡發明創新風氣，並為國爭取最高榮譽。
- 二、主辦大會：國際發明聯盟總會（IFIA）。台灣授權單位：台灣發明協會
- 三、參展日期、地點：2026年8月14日~8月16日，美國聖克拉拉會議中心舉行，共為期3天。
- 四、即日起報名至2026年5月30日截止。（參賽簡章請參考附件）
- 五、報名相關問題歡迎洽詢本會承辦人：秘書處 吳秋瑾 小姐。電話：(02)6605-7626。電子郵件：tia7626@yahoo.com.tw。歡迎透過LINE官方好友：@tia1972 與我們聯



繫。

正本：屏東縣立明正國民中學、屏東縣立中正國民中學、屏東縣立鶴聲國民中學、屏東縣立至正國民中學、屏東縣立公正國民中學、屏東縣立潮州國民中學、屏東縣立光春國民中學、屏東縣立東新國民中學、屏東縣立內埔國民中學、屏東縣立崇文國民中學、屏東縣立萬丹國民中學、屏東縣立萬新國民中學、屏東縣立新園國民中學、屏東縣立長治國民中學、屏東縣立鹽埔國民中學、屏東縣立高樹國民中學、屏東縣立里港國民中學、屏東縣立九如國民中學、屏東縣立萬巒國民中學、屏東縣立佳冬國民中學、屏東縣立林邊國民中學、屏東縣立竹田國民中學、屏東縣立琉球國民中學、屏東縣立南州國民中學、屏東縣立麟洛國民中學、屏東縣立新埤國民中學、屏東縣立車城國民中學、屏東縣立滿州國民中學、屏東縣立瑪家國民中學、屏東縣立泰武國民中學、屏東縣立牡丹國民中學、屏東縣立獅子國民中學、屏東縣立恆春國民中學、屏東縣私立南榮國民中學、中華台北著作權人協會

副本：



台灣發明協會 理事長 張家菊



# 2026年第5屆美國矽谷國際發明展

## 邀請函

發明先進：敬啟

美國是我國最大的貿易市場，每當有新產品問市，莫不以進入美國市場為第一考量，今年美國 SVIIF 即將在八月開展，本會將組團參加，盼有新產品之發明人或廠商，欲獲取美國市場者，美國矽谷國際發明展將是一項最佳選擇，想藉由參加此大展吸取經驗者，千萬不要錯失這一年一度的發明展出盛會。

往年美國發明展展出時，全球各地工商人士都前往參觀，各國新聞媒體均前往採訪報導，您有可能一夕之間舉世聞名，又可觀摩世界各國發明家的新作品以予學習改進參考，一舉數得。

今年我們除了傳承以往的優點外，本屆展覽預計有廿餘國參展，敬盼與您同行。

**2026年 SVIIF 於 8月14日~16日開展**

**假聖克拉拉會議中心舉行**

**即日起接受報名至 5月30日截止**



台灣發明協會  
美國矽谷參展團

團長 **張家菊** 敬邀

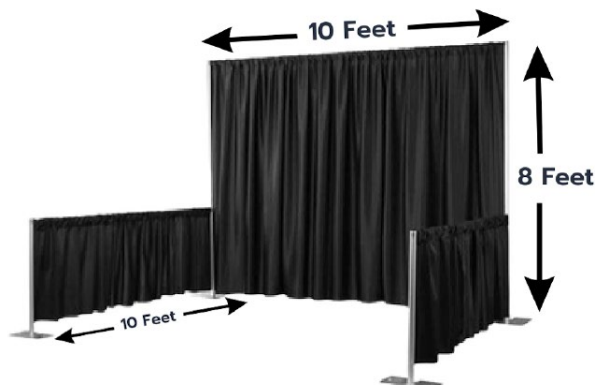
# SIF 2026 美國矽谷國際發明展-參展辦法

- 一、宗旨：為宣揚我國工業技術能力、促進國際科技交流、爭取國家榮譽、增進國民外交、拓展發明新產品海外市場及提高新產品之行銷市場價值。
- 二、主辦單位：國際發明聯盟總會(IFIA)
- 三、台灣授權單位：台灣發明協會
- 四、團名：2026 美國矽谷國際發明展-台灣參展團
- 五、依據：美國矽谷國際發明展大會組團授權書
- 六、展覽會名稱：Silicon Valley International Invention Festival 2026
- 七、展出日期：2026 年 8 月 14 日~8 月 16 日
- 八、展出地點：USA, California, Santa Clara Convention Center  
5001 Great America Pkwy, Santa Clara, California 95054, United States
- 九、費用：
  1. 參展費：每件作品**\$60,000 元**。  
(包含報名費、展位費、評審費、入場證、1 桌 2 椅及電源費)。
  2. 海報費：每件**\$1,000 元**(自理者免繳)。
  3. 代展費：每件**\$10,000 元**。  
(代展作品需提供 3 分鐘內影片，請上傳 YouTube 後提供網址。)
  4. 個人旅費：預估 14 萬左右。欲隨團者，請提供隨團報名表及護照影本，後續由旅行社聯繫。如未達成團人數，將改為自行前往。
  5. 作品攤位由協會安排，如需獨立攤位則需另加攤位費**\$30,000 元**。
  6. 現場中英翻譯人員 160 美元/日(請自行交付翻譯人員，本會不代收。)
- 十、即日起接受報名至 2026 年 5 月 30 日截止。

※ 截止日前資料未繳交齊全者將無法刊登於矽谷展覽大會專刊。

※ 指定轉角攤位者須另加台幣 10,000 元。(有預訂並繳款者優先)

攤位示意圖：



## 繳交參展資料明細單：

請以電子檔文件：tia7626@yahoo.com.tw

寄件主旨請輸入□□□(個人名、學校名或公司名)報名美展。

文字部分請交 **word** 檔，照片圖檔請以 **jpg** 檔文件，每件作品請獨自建立一個資料夾，報名一件以上之作品，請於資料夾上輸入編號，以便雙方核對或通知補件，謝謝。

- 1. 已填妥之報名表(一件作品填寫一份報名表，需詳細填寫完整)  
含產品介紹中、英文(約 150 字左右)
- 2. 參展切結書(請由該件作品一位發明人代表簽名或蓋章)
- 3. 參展品專利證書檔案或申請中收據(無專利者免附)
- 4. 參展品照片檔案(每件作品建議提供二張)
- 5. 隨團前往參展人員請附上隨團參展表(含護照影本)
- 6. 自行前往參展人員請提供人數及中英文姓名
- 7. 發明人或聯絡人名片
- 8. 聘請翻譯人員切結書(無聘請者免填)

報名日期：即日起接受報名至 5 月 30 日截止

聯絡地址：(241-608)新北市三重區重陽路一段 1 號 4 樓之 11

聯絡人：秘書處 吳秋瑾 小姐

聯絡電話：02-6605-7626

E-mail：tia7626@yahoo.com.tw

- 參展資料請連同全額參展費於報名截止日前繳交至本會，以完成報名手續。  
(以上資料未齊全或未繳付全額參展費者，歉難受理報名。)
- 電匯資料：新光銀行(銀行代碼 103) 北三重分行  
戶名：“**社團法人台灣發明協會**”。 帳號：“**0310-10-100304-3**”。

@tia1972



台灣發明協會  
官方好友 LINE



# 2026 美國矽谷發明展參展報名表

發明人姓名	發明人填寫姓名注意事項：範例：王小明 Hsiao-Ming Wang ※此欄為若得獎，獎狀上的得獎者姓名，一位以上之發明人，請一律填寫於此，資料一旦送出，不得變更修改。		
	(中)		
上限 10 位，超過將取前 10 位。 請勿修改表格	(護照英文名)		
	公司/學校名稱		統一編號
(中)			
(英)			
聯絡地址			
(中)			
(英)			
電話		手機	
E-mail		http://	
聯絡人	姓名： 電話： E-mail:	職稱：	參展品類別 (請參閱選項 填入一編號)
是否隨團參展： <input type="checkbox"/> 是，共__人。欲隨團者，請提供隨團報名表及護照影本，後續由旅行社聯繫。如未達成團人數，將改為自行前往。			
<input type="checkbox"/> 不跟團，共__人自行前往。(請提供名單) <input type="checkbox"/> 委任協會代理。(另加代展費 10,000 元/件)			
海報： <input type="checkbox"/> 自行排版製作輸出 <input type="checkbox"/> 協會排版製作輸出(\$1,000) <input type="checkbox"/> 自行排版檔給協會輸出(\$1,000)			
台灣專利	<input type="checkbox"/> 發明_____號 <input type="checkbox"/> 新型_____號 <input type="checkbox"/> 設計_____號		
專利名稱			<input type="checkbox"/> 公告中案號_____號 <input type="checkbox"/> 申請中案號_____號
展品名稱	(中)		
	(英)		
展品介紹	展品介紹(簡易中英文各約 150 字左右)		

(一件作品填寫一份報名表，需詳細填寫完整，作品照片請勿貼在此，以利作業，謝謝。)

## CLASS - CHECK THE CATEGORY OF YOUR INVENTION (產品種類)

A	Mechanics(機械學) / Engines(引擎) / Machinery(機械) / Robotic(機器人學) / Tools(工具) / Industrial process(工業生產流程) / Metallurgy(冶金學)
B	Electronics(電子) / Electricity(電力) / Methods of Communication(電力通信方法)
C	Building(建築) / Architecture(建築學) / Civil Engineering(土木工程) / Construction(建造) / Materials(材料) / Woodwork(木工)
D	Sanitation(公共、環境衛生) / Ventilation(通風設施) / Heating(暖氣)
E	Security(安全) / Rescue(救援) / Alarm(警報裝置)
F	Housekeeping (家務管理) / Nutrition(營養學)
G	Commercial, Industrial and Office Equipment (商業、工業以及辦公室的設備)
H	Agriculture(農業) / Forestry and Garden(林業及園藝) / Pet and Farm Animal Supplies(寵物及家畜相關產品)
J	Traffic(交通) / Transport(運輸) / Car Accessories(汽車用品)
K	Graphic Arts(平面藝術) / Advertising(廣告)
L	Games(遊戲) / Sport(運動) / Hobbies(嗜好)
M	Medical Technology (醫藥科技) / Medical Engineering (醫學工程) / Medicine (藥品) / Hygiene (衛生)
N	Hardware(硬體) / Software(軟體) / Cybersecurity(網路安全) / Blockchain(區塊鏈) / Internet of things (IoT)(物聯網)
O	Teaching Research (教學研究) / Pedagogical Items (教學項目)
P	Energy (能源) / Renewable and green energy (再生及綠色能源)
Q	Paramedical (輔助醫療) / Health (健康) / Foodstuffs (食品) / Drinks (飲品) / Cosmetics (化妝品)

# 切 結 書

※一份作品請一位發明人代表填寫一份切結書

本人(公司)參加 2026 美國矽谷國際發明展，其報名表內填寫之所有內容，皆已再次確認無誤，同意報名表送出後，不得再做任何修改變更，含若得獎的得獎證書亦同。

同時願意遵守大會一切規定，並絕對尊重大會國際裁判的評審結果，絕無異議。

立書人

姓 名： (簽/蓋章)

身分證字號：

住 址：

電 話：

作品名稱：

中華民國 年 月 日